

セラミックス業界初!超スピード短納期を実現!
品質重視で安心なセラミックスを1個から
お試しください

〒146-0082 東京都大田区池上7-26-10

TEL 03-3755-0660 FAX 03-3755-0708

MAIL m-kaneko@ceramic.co.jp

URL <https://ceramic.co.jp/>

担当者 金子 素子

特長



主要設備

マシニングセンター、旋盤、フライス盤、射出成型機、円筒研磨機、平面研磨機、
3D-CAD/CAM

得意な加工技術

旋盤・NC旋盤加工 フライス・M/C加工 プレス・板金加工 研削加工 研磨加工 溶接加工
樹脂成形加工 ゴム成形加工 放電加工（ワイヤー・形彫）ばね・ワイヤーフォーミング加工
ガラス・レンズ加工 セラミックス加工 熱処理 めっき・蒸着・表面処理 塗装 金型製作
MIM（金属粉末射出成型）3Dプリンター（積層造形法）鋳造・ダイカストロストワックス
鍛造 各種試作開発 その他加工